

特 許 公 報 (A) 昭61-75558

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

特 許 公 報

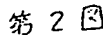
特 許 公 報

BEST AVAILABLE COPY

(發明のため)
以上の通り本發明によりは枚以上の片面実装基
材からなる配線基体回路装置が実現できゝため従

4. 因計の部が在現地

代理人 弗理士 門 限



08/48552

54) HYBRID INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

(11) 61-75558 (A) (43) 17.4.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-198008 (22) 21.9.1984

(71) NEC CORP. (72) KAZUHARU ISHIHAMA

(51) Int. Cl. H01L27/13; H05K1/18

PURPOSE: To improve the mounting density and to provide extensible and flexible functions of a hybrid integrated circuit device by connecting two or more substrates on which parts are mounted on both or one side surface with each other at external terminals.

CONSTITUTION: A semiconductor pellet 2 is placed on a thick film substrate 1 printed on both side surfaces and on the back surface, connected by a gold wire 3, coated with a silicon resin 4, and a chip capacitor 5, a small-sized molded semiconductor 6 and an U-shaped external terminal 7-a are connected by soldering to the surface. The terminal 7-a is inserted to the bent U-shaped recess of the external terminal 7-b of the second substrate assembled in the similar steps, and electrically connected. Parts are mounted on both side surfaces by superposing the external leads on the substrate by utilizing the U-shaped portion as described above. Thus, twice mounting density can be achieved in the same area as compared with the conventional technique. the substrates are superposed in 3 and 4 stages to further increase the mounting density.

